

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示：

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，并于2024年7月11日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，旨在进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、重视股东回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期可持续的价值。2024年以来，公司积极实施现金分红、资本公积转增、回购及控股股东增持，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。

（一）持续积极实施现金分红

自2023年2月科创板上市以来，公司连续两年实施现金分红。2022年度，公司以总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利20,777,658.60元（含税），2022年度公司现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.02%。

2023年度，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.0255元（含税），合计

派发现金红利96,471,274.35元（含税），2023年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为93.94%。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，合计转增33,015,728股，转增后公司总股本由69,264,862股增加至102,280,590股。

（二）积极实施股份回购

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。回购股份的价格不超过人民币88.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司进行2023年年度权益分派，上述回购股份价格上限于2024年6月3日由不超过人民币88.00元/股（含）调整为不超过人民币58.65元/股（含）。

截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份482,095股，占公司总股本102,280,590股的0.4713%（以公司资本公积金转增股本后的总股本102,280,590股为基数计算），回购成交的最高价为86.48元/股，最低价为75.21元/股，支付的资金总额为人民币40,018,427.23元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。累计回购资金总额已达到本次回购计划下限。

（三）控股股东、实控人、董事长积极增持公司股份

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理FENG CHEN先生于2024年7月5日在上海上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份55,420股，占公司总股本的0.05%，合计增持金额为人民币289.97万元（不含交易费用）。该增持行为体现了公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理FENG CHEN先生对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，增强了广大投资者对公司的投资信心，维护了全体股东的利益。

2024年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，

积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

二、持续自主创新，持续构建核心竞争力

（一）提升产品性能，开展前瞻性研发

公司始终紧跟市场趋势加强对产品和技术的前瞻性研发，积极迎接8K超高清显示全面普及带来的市场机遇和挑战，围绕自身技术优势开展多项研发工作。对现有产品进行规范和性能升级、支持更高分辨率和数据传输带宽，同时进一步巩固产品的高兼容性和低功耗、低延迟、高可靠性等特点。公司研发的4K/8K超高清视频信号桥接芯片开始批量出货，成为市场上少数可兼容多种超高清信号协议，支持包括视觉无损视频压缩技术、视频缩放、旋转及分割等视频处理功能和8K显示的单芯片解决方案产品，满足了新一轮4K/8K显示器的升级换代需求以及AR/VR、超高清商业显示的市场需求。

公司进一步丰富现有产品矩阵，同时利用在高速数据传输和视频传输接口技术领域多年的技术积累，积极研发面向HPC、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片。

（二）加强车载芯片研发，积极拓展汽车电子领域

汽车电子作为公司重要的业务拓展方向，公司持续加大在该领域的研发投入和新品布局。截至目前，公司部分高清视频桥接芯片凭借良好的兼容性和稳定性已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域，其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证，并收录于《工信部汽车芯片产品推广应用目录》和《长三角汽车芯片产品手册》。该领域的业务规模快速上升。

公司积极开展与车厂、Tier1厂商的合作，积极拓展客户的同时，积极推进ASPICE体系建设和ISO 26262标准认证，旨在进一步提升车规产品质量管控等级。

（三）推进募投项目建设，增强公司发展保障

2023年2月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币10.30亿元，重点建设的“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”和“高速信号传输芯片开发和产业化项目”产业化项目，将在公司现有两大产品线的基础上，进一步加大研发投入，推进公司核心产品的升级迭代，开发更为先进的高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片，满足安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等终端领域不断升级的市场需求；“研发中心升级项目”将通过扩建与升级研发中心进一步提升公司研发创新能力，为公司的长期发展提供技术支撑；“发展与科技储备资金”将紧密围绕公司的业务规划和战略目标，增强公司的运营弹性，为公司的可持续发展提供资金保障。具体如下：

1、高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目

高清视频桥接及处理芯片主要是对各种高清视频信号进行协议转换及功能处理，使得信号可以满足不同设备或装置的使用需求。此类芯片产品可实现协议转换、视觉无损压缩与解压缩（DSC）、缩放、旋转、梯形矫正、视频拼接与分割、帧率转换、色彩空间处理、亮度处理、高动态范围图像处理（HDR）、3D画面分割、屏幕菜单式调节方式（OSD）、音频数据接收、发送时钟恢复、声音回传（ARC/eARC），以及高带宽数字内容加解密（HDCP）等功能，进而完成播放设备或者信号源与应用终端设备的匹配，达到最佳的视听效果。

该项目是在公司现有高清视频桥接及处理类芯片产品系列基础上进行迭代升级并产业化应用，重点开发新一代高清视频信号发送、接收、转换、显示器控制、视频处理等多个系列的新型芯片，丰富和升级高清视频桥接及处理芯片产品方案。项目总投资金额为28,167.06万元，计划投入募集资金总额为25,745.06万元。截至2023年末，本项目已累计投入6,539.56万元。

2024年，公司将紧跟全球高清视频桥接及处理芯片产业的发展趋势，扩大该项目领域的技术能力与产品能力，持续提升公司市场地位。同时，公司会持续加强本募投项目管理，在该募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进

公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司发展保障。

2、高速信号传输芯片开发和产业化项目

公司高速信号传输芯片应用于信号在两个或多个外部设备间或者设备内有线传输过程。可实现高速信号的视觉无损编解码、调整、增强、延长、分配、切换、音频植入和分离、数字内容加解密（HDCP）等功能，具有低功耗、低延迟、高带宽、高可靠性等特点。

本项目是在公司现有高速信号传输芯片产品系列基础上进行迭代升级并产业化应用，重点开发新一代高速信号传输切换、分配、中继、矩阵交换等多个系列的新型芯片，丰富和升级高速信号传输芯片产品方案。项目总投资金额为17,664.32万元，计划投入募集资金总额为16,502.32万元。截至2023年末，本项目已累计投入1,660.38万元。

2024年，公司将紧跟全球高速信号传输芯片产业的发展趋势，扩大该项目领域的技术能力与产品能力，持续提升公司市场地位。同时，会持续加强本募投项目管理，在该募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司发展保障。

3、研发中心升级项目

为适应公司发展规划的要求，强化技术管理，促进科技创新，公司有计划的扩建研发中心，实施公司的技术研发与科技创新各项工作，在提升现有研发能力的同时，积极跟踪研究和导入新的技术与产品。通过提升硬件设备与软件水平，搭建更为完善的研发设计平台及实验室。中心重点研发方向主要包括：下一代SERDES 技术研发；应用于车载系统的超高清视频传输和显示芯片研发；8K超高清视频处理及显示芯片；企业级USB、PCIe Hub/Switch系列芯片等研发方向。项目总投资金额为34,667.69万元，计划投入募集资金总额为33,547.69万元。截至2023年末，本项目已累计投入1,406.70万元。

2024年，公司将进一步进行能力提升和建设。通过加强对高水平拔尖人才、科技骨干的引进和培养，优化研发队伍人员结构；通过改善软硬件条件，使公司

有能力加强科技攻关力度；通过对现有设备技术进行改良和提升，提高原有产品工艺制程；通过研发的逐渐深入，逐步转向附加值更高的市场领域。同时，会持续加强本募投项目管理，在该募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金。

三、优化运营管理，提高经营质量

（一）强化管理体系，推行全员质量管理

公司在体系建设、过程管理、产品认证、客户服务等方面多措并举，落实质量效益。进一步加强代工厂过程管控，对产品质量分析追根求源，产品良率和质量进一步提升。细化PCN管理，缩短了客户测试周期，提升了客户的信任度和粘性。顺利通过多家知名客户现场或线上审核。2024年，公司将以体系认证和客户需求为导向，进一步落实流程梳理和管理改进，推行全员质量管理，提高质量意识。

（二）落实国际化战略，设立新加坡全资子公司

为进一步拓展海外市场，提高全球供应链采购能力，提升国际市场占有率及公司整体抗风险能力，提高市场竞争优势，公司于2023年12月22日在新加坡设立境外全资子公司。此举是基于公司战略发展规划的考虑，有助于公司国际化的长远发展。2024年，公司将持续履行客户全球化发展战略，在立足国内超大规模市场的前提下，积极适应国际形势，加强全球市场的开拓，并着重在新产品、新应用拓展和新领域开发，提高公司在全球市场占有率。

（三）加大研发投入，加快研发团队建设

公司高度重视创新能力建设，2024年，公司将持续加大研发投入、进一步提升研发平台硬件设施水平，多举措壮大研发团队，优化组织架构，增强研发队伍实力，有针对性的围绕高性能计算、汽车电子等业务方向进行人才储备、资源储备，完善研发管理体系，进一步提升产品工艺水平，持续开展对前沿技术的可行性研究。切实关注员工身心健康、安全和满意度，进一步为员工提供舒适、优化工作环境。

（四）实施股权激励，优化员工考核要求

2024年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了《2024年限制性股票激励计划》。计划亦设定了营业收入增长率、毛利率的公司层面业绩考核要求，也设定了个人层面的业绩考核要求，锚定公司成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标绑定管理层和员工的利益与公司发展目标共同达成，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

2024年，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的要求，努力完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，根据最新监管法规，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等进行修订，不断提升公司治理水平。公司坚持可持续发展理念，积极践行社会责任。

（一）落实独董制度，强化独立董事监督作用

公司持续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，积极落实公司最新修订的《独立董事制度》，为独立董事开设办公场地，便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作，并指定专人负责对接，为独立董事履职提供便利条件。公司独立董事通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种有效形式了解公司进展，公司也将及时向独立董事汇报经营重大事项，保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督职能。

（二）强化“关键少数”责任，提升治理能力

2024年，公司将继续与公司大股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

（三）优化内部控制体系

2024年6月，为进一步完善公司治理结构，建立健全管理机制，公司对包括《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》等多项内控制度进行修订。同时，为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，公司特制定了《会计师事务所选聘制度》，并颁布实施。

未来，公司将持续关注法律法规和监管政策变化，通过及时更新修订公司内部管理制度，确保三会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证各职能部门有效发挥应有的功能，促进组织的有效运营和目标实现，助力公司实现高质量发展。

五、高质量信息披露，积极传递公司投资价值

2024年，公司将继续遵循信息披露法规及投资者关系管理制度相关要求不断提高信息披露质量，持续畅通与投资者交流渠道，积极传递公司投资价值。

（一）提高信息披露质量

2024年，公司将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时，公司将不断提高公告编写水平，力求公告内容通俗易懂、简明扼要，以便投资者更便捷高效地获取公司重大投资信息，更好地传达公司的投资价值。

（二）加强与投资者沟通交流

公司将继续根据《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等规定，不断强化投资者关系管理，畅通与投资者沟通交流的渠道，为广大投资者了解公司、参与公司重大事项决策创造便利条件，以提高投资者对公司的认同感。

2024年，公司将于每次定期报告后，召开公司管理团队参与的业绩说明会，并按法规要求提前发布相关公告并邀请投资者参与会前提问，会上及时、耐心解答投资者提问，让投资者更全面地了解公司生产经营情况，积极传递公司价值。通过“上证e互动”交流平台及时回复投资者关切问题、认真接听投资者来电等

多种形式，与投资者保持常态化良性互动实时沟通公司经营理念，增进互动的广度和深度，实现常态化良性互动；在听取投资者对公司经营管理的建议后及时反馈至管理层，以积极应对市场变化；确保投资者热线、官方邮箱等渠道畅通，在信息披露允许的范围内详细解答投资者问题，与投资者有效互动，以不断加强与投资者的沟通交流，提高投资者关系管理水平。

2024年下半年，公司将组织、参与投资者线上线下路演交流活动不少于10次，让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持，打造高效透明的沟通平台。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年7月16日